

Karta Techniczna Produktu

ZALEWA SILIKONOWA DWUSKŁADNIKOWA 029 (kondensacyjna)



Produkt jest płynnym materiałem zalewowym, dwuskładnikowym, przewodzącym ciepło. Utwardzanie zachodzi w temperaturze pokojowej. Materiał zapewnia przewodność cieplną i małą rozszerzalność. Idealny do zalewania lub wypełniania szczelin w wydzielających ciepło elementach elektronicznych z metalowymi obudowami lub radiatorami.

Posiada doskonałą płynność przy dozowaniu i zalewaniu. Po utwardzeniu nie odrywa się wskutek cyklicznego nagrzewania od powierzchni do której przylega. Utwardzony produkt jest suchy w dotyku.

Sposób użycia: Układ należy oczyścić, odtłuścić i wysuszyć. Zawartość strzykawki (utwardzacz) dodać do pojemnika z zalewą i dokładnie wymieszać. Zalać układ i sezonować przez około 24 godziny w temperaturze pokojowej.

Zastosowania: Hermetyzacja układów elektronicznych/elektrycznych. Przetworniki energii. Półprzewodniki mocy. Zasilacze. Elektronika samochodowa. Sterowanie ruchem. Telekomunikacja. Komputery i urządzenia peryferyjne. Między wytwarzającymi ciepło półprzewodnikami lub elementami magnetycznymi a radiatorami. Strefy, w których występuje potrzeba przekazywania ciepła do ramy, podstawy montażowej lub innego elementu rozpraszającego ciepło. Stosowanie zalewy kondensacyjnej w układzie zamkniętym może powodować pojawienie się nieszkodliwego białego nalotu, który nie wpływa na działanie układu. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w magazynach suchych w temp. nie wyższej niż 30°C.

Przewodność cieplna - ~2W/mK

Opakowania:

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
100g + 10g	2	ART.AGT-221